

Pain de Seigle au Levain Kayser



Préparation : 20 minutes
Repos : 3 heures
Cuisson : 50 minutes

Ingrédients :

- * 350 g de farine T65
- * 150 g de farine de seigle T130
- * 280 g d'eau
- * 150 g de [levain Kayser](#)
- * 1 pointe de CC de levure sèche Gourmandises®
- * 10 g de sel

Préparation :

Versez la farine et l'eau dans le bol de votre Cook'in. Pétrissez pendant 2 minutes, puis laissez reposer dans le bol pendant 30 minutes.

Ce temps passé, ajoutez le levain, la levure et le sel dans le bol et recommencez le pétrissage (2 minutes).

Préparez le bol plastique avec un peu de farine au fond puis déposez-y la pâte en boule, recouvrez d'une toile Silpat® et laissez-la pousser pendant 30 minutes à température ambiante.

Déposez la pâte sur une toile ROUL'PAT® légèrement fariné. Formez un carré et pliez la pâte de haut en bas, de gauche à droite, de bas en haut puis de droite à gauche. L'ordre n'a pas d'importance. Retournez la pâte, pliez en dessous, façonnez rapidement en boule et déposez-la sur une toile Silpain® et laissez pousser 1 heure.

Réalisez ensuite des entailles à l'aide d'une incisette et laissez encore pousser pendant 1 heure.

Mettez dans le four (**départ à froid**) pendant 50 minutes à 240°C (th.8).

Personnellement j'ai mis le programme A-23 de mon Samsung-NV70F7796MS (55 minutes, mais je ne pourra pas vous dire à combien, ce n'est pas indiqué dans la notice).

Note : Pour vérifier la cuisson du pain tapotez dessus et si cela sonne creux, il est cuit. A mi cuisson, j'ai posé un bol d'eau chaude dans le fond afin de faire de la buée.

